

商品情報

	商品名	Hephaistos™ Laser Bonding System	FOB	
	HP	http://www.aqlaser.com/	MOQ	1

	<p>本システムは、半導体パッケージング工程に最適化された高精度レーザー接合ソリューションで、HBM、LED、Micro LED/OLED、先端ICパッケージングなど、様々な高付加価値半導体およびディスプレイアプリケーションに適用できます。</p> <p>Laser TC Bonding、Laser Reflow、Fluxless Bonding工程をすべてサポートし、ローディング、フラックスディッピング、予熱、ボンディング、アンローディングに至る全工程を完全自動化された工程の流れで具現して高い生産性と安定した量産品質を同時に満たします。</p> <p>精密なレーザーエネルギー制御技術により接合品質の反復精度を確保するとともに、最小限の熱影響により素子損傷と熱変形を効果的に抑制します。</p> <p>また、四角形や長方形パターンに最適化されたカスタマイズ型光学設計を適用し、均一なエネルギー分布と優れた接合均一度を実現しました。</p> <p>非接触方式のレーザーリフローボンディングと高速モーション同期化制御技術により、高速処理と高精度接合を同時に実現し、コンパクトなモジュール型システム構造で生産ライン構成の柔軟性と拡張性を提供します。</p> <p>※ 主な技術的特性</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2μm以下平坦度及び整列精度 - 0.5~4秒高速ボンディング - 1~10μmボンディング精度 - チップレット及び3Dパッケージ選択的ボンディング - XY ビーム サイズ 調節 - クオーツベースの高耐久性ボンディングツール - 位置別温度制御 			

包装	サイズ	個数	重さ	備考
1個あたり				
内寸				
外寸				

FOB	
MOQ	1
サンプル提供価格	

商品仕様	
分類名称	
原産地	大韓民国
資源再利用可否	
重さ	
内容量	
セット内容	
使用期限	

使用方法	
PC制御により設備を駆動・量産	

注意事項	
レーザー応用設備として工程進行中に発振されているレーザーに対して注意が必要であり、自動化設備として設備稼動中に注意が必要	

企業紹介	
当社は2016年に設立された半導体レーザー工程装備専門企業で、レーザー接合、ドリリングなど多数の工程技術を独自開発・保有し、技術内在化および特許確保など半導体レーザー工程総合ソリューション企業としても展開しています。	
主要輸出国	

商品情報



商品名

Ares™ Laser Singulation System

HP

<http://www.aqlaser.com/>

FOB

MOQ

サンプル提供価格

商品仕様

分類名称

原産地 大韓民国

資源再利用可否

重さ

内容量

セット内容

使用期限

使用方法

PC制御により設備を駆動・量産

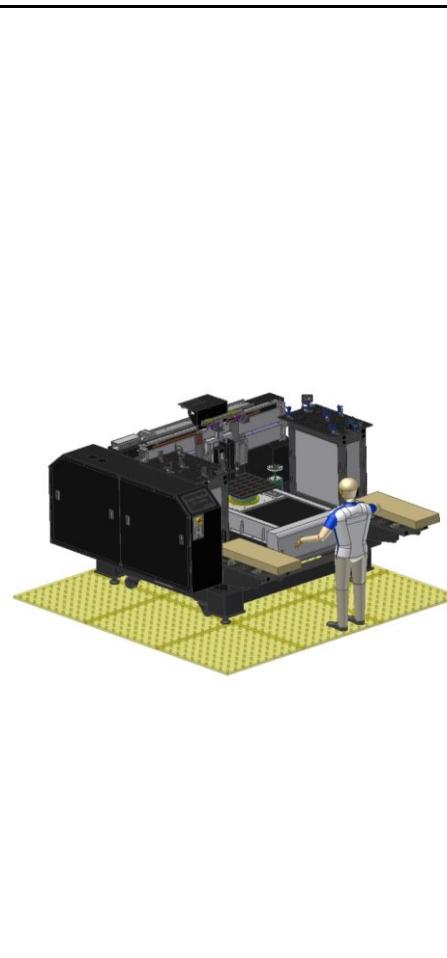
注意事項

レーザー応用設備として工程進行中に発振されている
レーザーに対して注意が必要であり、自動化設備として
設備稼動中に注意が必要

企業紹介

当社は2016年に設立された半導体レーザー工程装備専門
企業で、レーザー接合、ドリリングなど多数の工程技术を独自
開発・保有し、技術内在化および特許確保など半導体レー
ザー工程総合ソリューション企業としても展開しています。

主要輸出国



本システムは、ABFレイヤーが積層されたビルドアップガラス基板およびガラスコア基板を対象とする高精度レーザーシングュレーション(Singulation)です。

上・下部レイヤーに対する精密レーザーグルービング(grooving)とガラスコア層に対する高精度レーザーカッティング(Cutting)工程を行い、制御された機械式またはレーザーブレーキング方式により剥離(delamination)なしにきれいな分離ができるように設計されました。

また、高精度測定及び光学検査モジュールが統合され、工程後の品質をリアルタイムで確認することができ、検査結果によってOK/NG自動分類機能を提供して量産工程の品質安定性を確保します。本システムは先端半導体およびディスプレイ用ガラスコアユニットの大量生産に最適化されたインライン(Inline)構造で設計され、高い処理量と安定した生産性を同時に提供します。

※ 主な技術的特性

- Chipping 5μm以下、10μm以下 Size 精度
- 515mm以上の大面积適用及び両面多層(0.2~1.8mm厚ガラス基板)工程可能
- 500um以下ABF Build up Layer加工技術
- SEWARE Free

包装	サイズ	個数	重さ	備考
1個あたり				
内寸				
外寸				

商品情報



商品名

Ares™ Laser Drilling System

HP

<http://www.aqlaser.com/>

FOB

MOQ

サンプル提供価格

商品仕様

分類名称

大韓民国

資源再利用可否

重さ

内容量

セット内容

使用期限

使用方法

PC制御により設備を駆動・量産

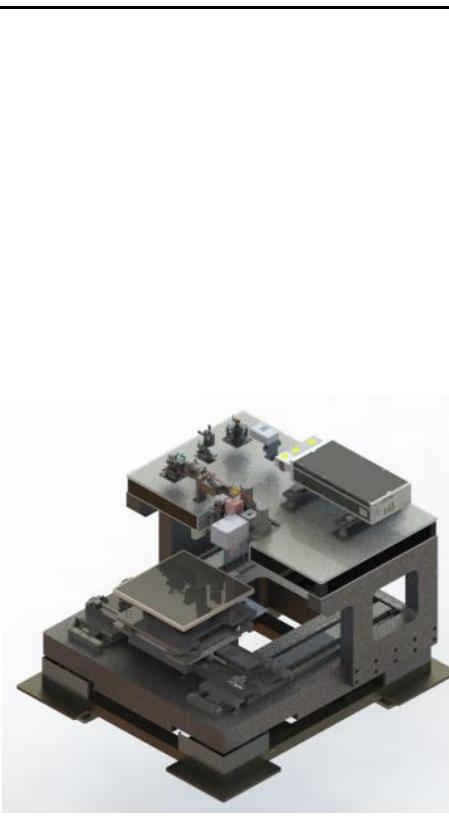
注意事項

レーザー応用設備として工程進行中に発振されている
レーザーに対して注意が必要であり、自動化設備として
設備稼動中に注意が必要

企業紹介

当社は2016年に設立された半導体レーザー工程装備専門
企業で、レーザー接合、ドリリングなど多数の工程技术を独自
開発・保有し、技術内在化および特許確保など半導体レー
ザー工程総合ソリューション企業としても展開しています。

主要輸出国



本システムは、ガラスおよび半導体基板を対象に超精密マイクロホール(Micro-hole)加工を行うレーザードリリングで、Through-HoleおよびBlind Via加工をマイクロンレベルの精度でサポートします。

高速ビームスキヤニングと精密モーションステージを適用し、大面積基板全領域に対して均一で安定したドリリング品質を実現し、多様な素材特性に対応するためにUV、Green、IRなど様々な波長のレーザーソースを選択適用できるように設計されました。

また、超短パルス制御技術と最適化された工程パラメータにより、熱の影響と微細な亀裂を最小限に抑え、高信頼性微細加工品質を確保します。

本システムは、TGV(Through Glass Via)、インターポーザビア(Interposer Via)の形成、Micro-LEDパッケージングなど、次世代半導体およびディスプレイパッケージング工程に最適化されています。

※ 主な技術的特性

- 光学系の独自設計と組み立て
- 高精度ビームシェーピング技術(Bessel、Gaussian、Axiconなど)
- 顧客企業と共同開発経験を保有
- 3μm未満工程精度、1.5μm以下位置精度
- 515mm以上の大面積適用及び両面多層(0.2~1.8mm厚ガラス基板)工程可能
- Glass + Polymer Film HI素材に対する多重工程が可能
- AR 1000 :1 (Laser Hole)

包装	サイズ	個数	重さ	備考
1個あたり				
内寸				
外寸				